



适用于印刷电路板 (PWB/FPC) 的表面处理药剂:

一、适用于印刷电路板 (PWB/FPC) 的无电解镀液:

产品名称	用途	特点
KG-510	碱性脱脂	去除粘接剂, 光刻胶残渣
KG-511	酸性脱脂	去除粘接剂, 光刻胶残渣
KG-512	酸性脱脂	减轻对光刻胶的腐蚀
KG-528	激活剂	硫酸类型/低Pd浓度
KG-529	激活剂	低盐酸类型/支持细线图案 (防止桥) /长寿命
KG-531	软无电解Ni-P镀液/柔性电路板用	中磷型 (6~8%) /耐屈挠性良好
KG-535	无电解Ni-P镀液/刚性电路板用	中高磷型 (8~10%) /耐腐蚀性良好
KG-536	软无电解Ni-P镀液/柔性电路板用	中高磷型 (8~10%) /耐屈挠性和耐腐蚀性良好
KG-537	软无电解Ni-P镀液/柔性电路板用	中磷型 (6~8%) /无铅/耐屈挠性良好
KG-110N	无电解Pd镀液	置换型/长寿命/浴稳定性良好
KG-110NSJ	无电解Pd镀液	置换还原型/Pd-P合金/浴稳定性良好
KG-543	无电解Pd镀液	置换还原型/无点蚀置换还原型/无点蚀/无氰/Au膜厚差小
KG-545	无电解Pd镀液	置换型/析出速度快
KG-545Y	无电解Pd镀液	置换型/点蚀少



深圳駿廣

JX日矿唯一授权代理商
深圳骏广电子材料有限公司

Http://www.jungunemc.com
电话: (86) 0755-2698 0389
邮箱: sale@jungunemc.com

二、适用于印刷电路板(PWB/FPC)的后处理药剂:

产品名称	用途	特点
KG-210	ENIG, ENIPIG及ENEPIG的后处理剂	水溶性/防氧化
KG-230	ENIG的后处理剂	水溶性/耐盐水喷雾性
TG-3M	防止Sn和Sn合金氧化	强酸性/防止热处理导致的氧化(变色)/无发泡性

三、适用于CCL和FCCL/一次防锈液:

产品名称	用途	特点
OP-1	印刷电路板铜连线的一次防锈	存放时的铜防锈